第29回最先端実装技術・パッケージング展 出展のお知らせ

テストチップをコアとした次世代半導体先端実装ソリューションプロバイダーの株式会社ウェル（所在地：東京都品川区、代表取締役：江田尚之）は、2015年6月3日(水) ～5日(金)東京ビッグサイトで開催されます第29回最先端実装技術・パッケージング展内 eX-tech2015に出展します。

弊社はプラズマソリューションカンパニーとして、あらゆる方式のプラズマ装置を開発・販売しております。今回の展示会では、下記の新製品5機種をご紹介させていただきます。

■ダイレクト/リモート方式大気圧プラズマ装置（プラズマ照射幅:100～1850mm）
微細な配線パターン品に対してダメージフリーのプラズマ処理
1台の装置でダイレクト/リモート方式に対応
ワーク厚10mm以上の立体形状且つ非導電性材質へのプラズマ照射

■高密度ラジカル大気圧エアープラズマ装置(プラズマ照射面積：5～15mmφ)
アルゴン・窒素ガス等を一切必要としない、低ランニングコストを実現

■大気圧窒素プラズマ装置
従来機より窒素ガス消費量を30%削減
プラズマ照射幅100～2500mmまで対応

■マルチガス対応ピンプラズマ装置

アルゴン・窒素・エアー等でプラズマ発生可能
プラズマ処理面積が1mmφ以下の局所部へのプラズマ照射

■RIEプラズマ装置
異方性ドライエッチング用途
・卓上型（チャンバーサイズ：300x230x300mm）
・量産機（チャンバーサイズ：500x500x500mm）

□主な用途
・半導体ICパッド部ドライ洗浄
・ダイボンディング前処理
・樹脂封止前処理
・アンダーフィル材塗布前処理
・超音波接合前処理
・レジストアッシング
・シリコンエッチング
・各種材料の表面改質（親水化、疎水化処理）
・液晶基板の端子洗浄
・FPC基板の表面改質
・COF/COG基板洗浄
・太陽電池
・DNAチップ
・各種材料への印刷前処理

■第29回最先端実装技術・パッケージング展（eX-tech2015）概要
［会期］2015年6月3日（水） ~6月5日（金） 3日間
［開場時間］AM10：00～PM5：00
［会場］東京ビッグサイト （東京都江東区有明3-21-1）
［ブース］3F-03-02
［出展内容］
ダイレクト/リモート方式アルゴンプラズマ装置
高密度ラジカル大気圧エアープラズマ装置
大気圧窒素プラズマ装置
マルチガス対応ピンプラズマ装置
RIEプラズマ装置

≪本件に関するお問い合わせ≫
株式会社ウェル 実装ソリューション営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-25 サンウッド品川天王洲タワー2F
Tel：03-5715-3501
Fax：03-5715-3502
info@welljp.co.jp

http://well-plasma.jp/

Generated by ぷれりりプレスリリース
https://www.prerele.com